

W800 芯片设计指导书

V1.10

北京联盛德微电子有限责任公司 (Winner Micro)

地址：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 6 层

电话：+86-10-62161900

网址：www.winnermicro.com

文档修改记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
V0.1	2020/04/30	初稿		
V0.2	2020/06/10	更新外围参数	Huzj	
V1.0	2020/07/20	增加 ADC 电路说明	Huzj	
V1.1	2020/08/04	删除冗余内容,增加 GPIO 上下拉电阻典型值	Huzj	
V1.2	2020/11/27	增加芯片电源脚说明	Huzj	
V1.3	2020/12/23	增加芯片防静电, layout 说明	Huzj	
V1.4	2021/4/14	修改防天线口静电电路	Huzj	
V1.5	20210602	修改天线部分说明	Huzj	
V1.6	20211009	修改天线部分说明	Linda	
V1.7	20220317	修改天线部分说明及 ADC 范围	Huzj	
V1.8	20220706	修改原理图部分	Huzj	
V1.9	20230612	修改 ESD 部分	Huzj	
V1.10	2024/5/8	修改地址; 删除管脚定义中 touch 相关描述; 修改了页码;	LM	

目录

文档修改记录	1
1 概述	3
2 管脚定义	3
3 芯片外围电路设计	6
3.1 RESET 复位电路设计	6
3.2 参考时钟电路设计	6
3.3 ADC 电路设计	7
3.4 射频电路设计	7
3.5 GPIO 设计	7
3.6 下载口	8
3.7 电源设计	8
3.8 防静电设计	9
4 Layout 设计	10
5 天线设计	12
5.1 外置天线	12
5.2 板载天线	12

1 概述

W800 芯片是一款安全 IoT Wi-Fi/蓝牙双模 SoC 芯片。支持 2.4G IEEE802.11b/g/n Wi-Fi 通讯协议；支持 BT/BLE 双模工作模式，支持 BT/BLE4.2 协议。芯片集成 32 位 CPU 处理器，内置 QFlash、SPI、UART、GPIO、I2C、I2S、7816 等丰富的数字接口；支持多种硬件加解密算法，内置 DSP、浮点运算单元与安全引擎，支持代码安全权限设置，内置 2MFlash 存储器，支持固件加密存储、固件签名、安全调试、安全升级等多项安全措施，保证产品安全特性。适用于智能家电、智能家居、智能玩具、无线音视频、工业控制、医疗监护等广泛的物联网领域。

2 管脚定义

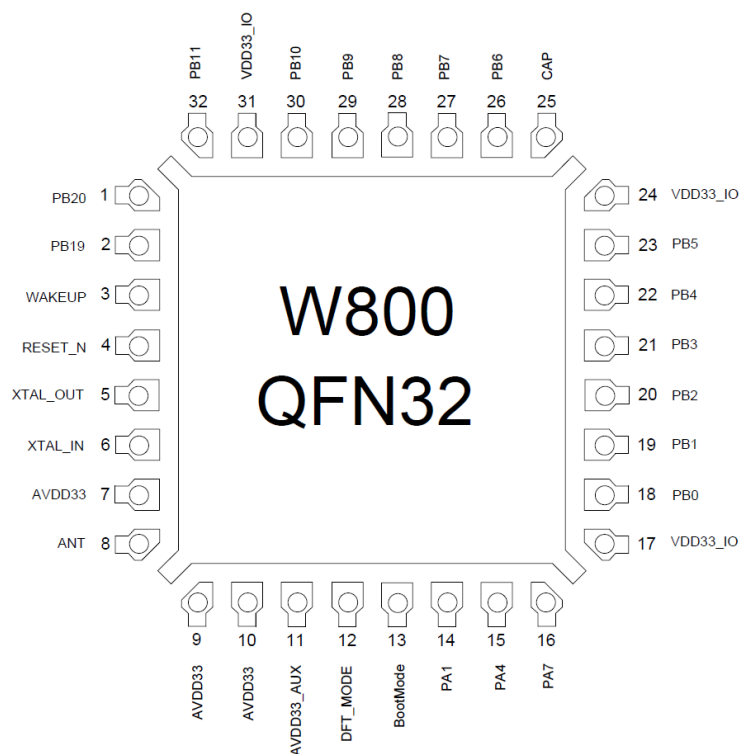


图 2-1 管脚布局图 (QFN32)

表 2-1 管脚分配定义 (QFN32)

编号	名称	类型	复位后管脚功能	复用功能	最高频率	上下拉能力	驱动能力
1	PB_20	I/O	UART_RX	UART0_RX/PWM1/UART1_CTS/I ² C_SCL	2MHz	UP/DOWN	12mA
2	PB_19	I/O	UART_TX	UART0_TX/PWM0/UART1_RTS/I ² C_SDA	2MHz	UP/DOWN	12mA
3	WAKEUP	I	WAKEUP 唤醒功能			DOWN	
4	RESET	I	RESET 复位			UP	
5	XTAL_OUT	O	外部晶振输出				
6	XTAL_IN	I	外部晶振输入				
7	AVDD33	P	芯片电源, 3.3V				
8	ANT	I/O	射频天线				
9	AVDD33	P	芯片电源, 3.3V				
10	AVDD33	P	芯片电源, 3.3V				
11	AVDD33_AU X	P	芯片电源, 3.3V				
12	TEST	I	测试功能配置管脚				
13	BOOTMODE	I/O	BOOTMODE	I ² S_MCLK/LSPI_CS/PWM2/I ² S_DO/PA0	30MHz	UP/DOWN	12mA
14	PA_1	I/O	JTAG_CK	JTAG_CK/I ² C_SCL/PWM3/I ² S_LRCK/ADC0	20MHz	UP/DOWN	12mA
15	PA_4	I/O	JTAG_SWO	JTAG_SWO/I ² C_SDA/PWM4/I ² S_BCK/ADC1	20MHz	UP/DOWN	12mA

16	PA_7	I/O	GPIO,输入, 高阻	PWM4/LSPI_MOSI/I ² S_MCK/I ² S_DI	25MHz	UP/DOWN	12mA
17	VDD33IO	P	IO 电源, 3.3V				
18	PB_0	I/O	GPIO,输入, 高阻	PWM0/LSPI_MISO/UART3_TX/PSRAM_CK	80MHz	UP/DOWN	12mA
19	PB_1	I/O	GPIO,输入, 高阻	PWM1/LSPI_CK/UART3_RX/PSRAM_CS	80MHz	UP/DOWN	12mA
20	PB_2	I/O	GPIO,输入, 高阻	PWM2/LSPI_CK/UART2_TX/PSRAM_D0	80MHz	UP/DOWN	12mA
21	PB_3	I/O	GPIO,输入, 高阻	PWM3/LSPI_MISO/UART2_RX/PSRAM_D1	80MHz	UP/DOWN	12mA
22	PB_4	I/O	GPIO,输入, 高阻	LSPI_CS/UART2_RTS/UART4_TX/PSRAM_D2	80MHz	UP/DOWN	12mA
23	PB_5	I/O	GPIO,输入, 高阻	LSPI_MOSI/UART2_CTS/UART4_RX/PSRAM_D3	80MHz	UP/DOWN	12mA
24	VDD33IO	P	IO 电源, 3.3V				
25	CAP	I	外接电容, 4.7μF			-	
26	PB_6	I/O	GPIO, 输入, 高阻	UART1_TX/MMC_CLK/HSPI_CK/SDIO_CK	50MHz	UP/DOWN	12mA
27	PB_7	I/O	GPIO, 输入, 高阻	UART1_RX/MMC_CMD/HSPI_INT/SDIO_CMD	50MHz	UP/DOWN	12mA
28	PB_8	I/O	GPIO, 输入, 高阻	I ² S_BCK/MMC_D0/PWM_BREAK/SDIO_D0	50MHz	UP/DOWN	12mA
29	PB_9	I/O	GPIO, 输入, 高阻	I ² S_LRCK/MMC_D1/HSPI_CS/SDIO_D1	50MHz	UP/DOWN	12mA
30	PB_10	I/O	GPIO, 输入, 高阻	I ² S_DI/MMC_D2/HSPI_DI/SDIO_D2	50MHz	UP/DOWN	12mA
31	VDD33IO	P	IO 电源, 3.3V				
32	PB_11	I/O	GPIO, 输入, 高阻	I ² S_DO/MMC_D3/HSPI_DO/SDIO_D3	50MHz	UP/DOWN	12mA
33	GND	P	接地				

注：1. I= 输入, O= 输出, P= 电源

3 芯片外围电路设计

3.1 RESET 复位电路设计

复位电路建议设计为 RC 电路，上电自动复位，W800 低电平复位。如果使用外部控制 RESET 管脚，当电平值低于 2.0v 时，芯片处于复位状态。复位时低电平需持续 100us 以上，见图 3-1。

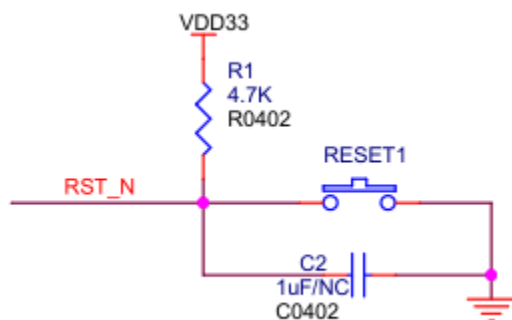


图 3-1 复位电路

3.2 参考时钟电路设计

芯片参考时钟选用 40MHz 频率，客户根据实际产品需求选用不同温度等级、稳定性、负载电容值的晶体。晶体两端所接负载电容根据不同厂家晶体 Load 值及频偏情况需要调整。参考设计中见图 3-2。

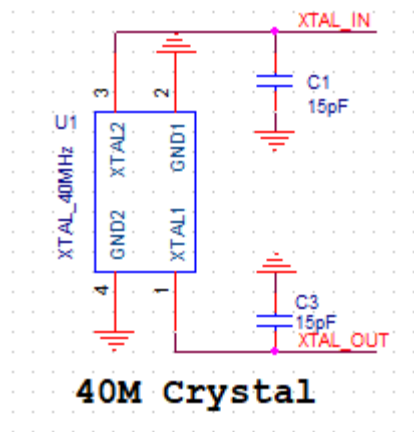


图 3-2 晶体电路

晶体摆放尽量靠近芯片，走线尽量短，并且远离干扰源，晶体周围多地孔隔离。时钟下面各层禁止其它走线穿过，防止干扰时钟源。晶振下无需挖空处理。

3.3 ADC 电路设计

芯片 14 脚 (PA1) 及 15 脚 (PA4) 脚可以作为普通 ADC 使用，输入电压范围 10mV~2.3V。当高于 2.3V 时外部需做分压处理后才可进入 ADC 接口。当采用分压方式时，为提高精度，R1 和 R2 需使用高精度电阻。根据 Sensor 输出电压值选择合适的 R1, R2 电阻值分压。如图 3-3 所示。

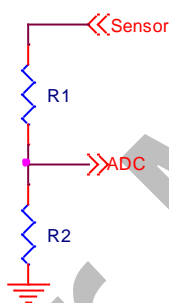


图 3-3 ADC 分压电路

3.4 射频电路设计

芯片采用单天线设计，内部集成了功放及收发切换开关，芯片射频端口阻抗 17-1.5jΩ。根据实际产品设计性能匹配要求，需预留图 3-8 参考设计匹配网络，根据实际天线阻抗值，优化外部设计匹配元件，匹配元件需要按照低通的形式设计，对二次谐波的抑制能力 10dB 以上。

3.5 GPIO 设计

芯片上电后 1, 2 脚默认为 UART0 端口，该端口提供下载及 AT 指令端口以及 log 输出端口。客户使用时注意不要随意使用该端口作为 GPIO 使用，防止被占用无法下载及调试。在系统起来后，该端口可以复用为其它端口使用。如果该端口被占用，可以按照 3.6 章节操作。

表 3-2 芯片 UART0 管脚说明

1	PB20	I/O	UART0_RX
2	PB19	I/O	UART0_TX

其余各个管脚复用关系及使用见表 2-1。所有 GPIO 如果配置上拉电阻，典型上拉电阻值为 40K，如果配置为下拉，典型下拉电阻值为 49K。

Wakeup 脚为外部唤醒脚，当芯片进入睡眠状态后，Wakeup 脚给高电平时，芯片唤醒。正常工作状态，该端口为低电平。

TEST 脚为芯片测试脚，该脚悬空。

3.6 下载口

W800 芯片默认 UART0 为下载口，芯片无固件初始下载时，直接连接 UART0 接口，通过相关下载软件即可实现固件下载。当芯片内有固件，再次进入下载模式，可以通过拉低 PA0，然后上电进入下载模式。下载完成后去掉 PA0 拉低的操作，需要重启，固件才能运行。

3.7 电源设计

芯片电源输入脚应放置相应滤波电容改善产品性能，外部对整个芯片供电建议选用 LDO，且总电流建议 500mA 及以上。总电源走线线宽要求不低于 30mil。供电范围 3.0V-3.6V。请勿超过该范围，超过 3.6V 可能会对芯片造成永久性损坏。低于 3.0V 可能会导致系统不稳定和整体性能下降。不同管脚放置电容见下述要求。

芯片 7 脚需放置 1uf 滤波器电容。

芯片 9 脚需放置 1nf 滤波器电容。见表 3-3。

表 3-3 芯片电源管脚说明

7	VDD33	P	芯片电源, 3.3V
---	-------	---	------------

9	VDD33LNA	P	LNA 电源, 3.3V	
---	----------	---	--------------	--

芯片 10 脚附近放置 47uf 滤波电容。

芯片 11 脚附近放置 47uf 滤波电容。

推荐客户在模块电源入口处放置 330uf 电解电容。见表 3-4。

表 3-4 芯片电源管脚说明

10	VDD33PA	P	PA 电源, 3.3V	
11	VDD33AUX	P	模拟电源, 3.3V	

芯片 17,24,31 脚附近可以根据条件放置 1uf 滤波电容。见表 3-5。

表 3-5 芯片电源管脚说明

17	VDD33IO	P	IO 电源, 3.3V	
24	VDD33IO	P	IO 电源, 3.3V	
31	VDD33IO	P	IO 电源, 3.3V	

芯片 25 脚 CAP 必须外接 4.7uf 滤波电容。

3.8 防静电设计

为了提高芯片防静电能力, 需在相关位置放置 2 颗防静电 ESD 保护器件, 天线采用倒 F 天线, 匹配电路见图 3-8 所示。在生产过程中做好静电防护, 防静电器件推荐型号参见原理图及 BOM 表。为满足产测需要, 在模块背面可以预留射频测试点 TP2。

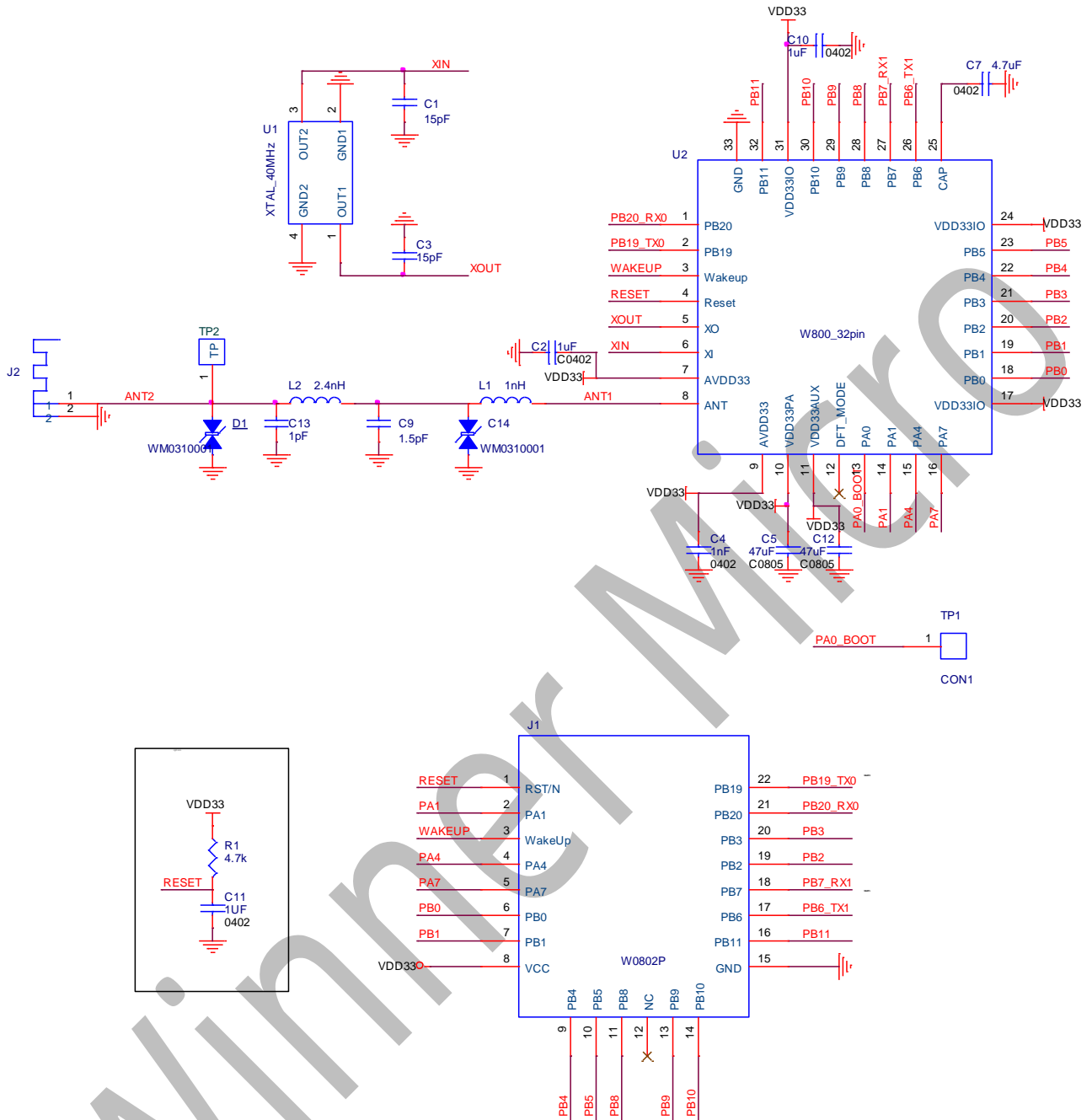


图 3-8 原理图及 ESD 管位置

4 Layout 设计

W800 芯片中间 PAD 是散热地焊盘，需要接地处理，同时需要打地孔，跟地良好接触散热，中间肚皮过孔不要做开窗设计。如图 4-1。

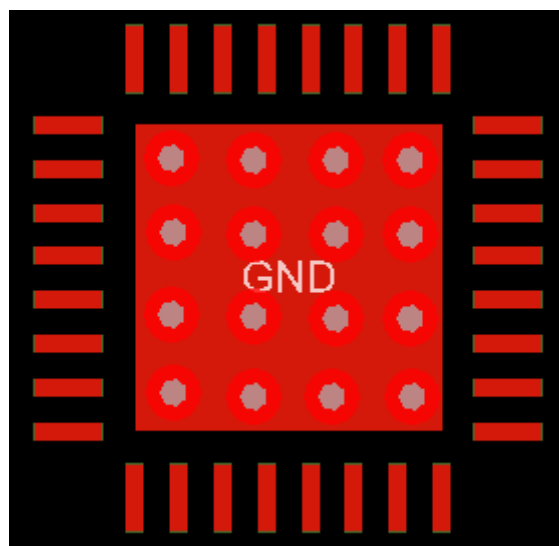


图 4-1 接地焊盘处理

产品设计完成后需要 PCB 所有层均做敷铜接地处理，需要保证第二层射频走线部分完整的地平面，保证射频阻抗连续性，同时射频走线根据板厚需要做 50 欧姆阻抗控制。

PCB 的 BOTTOM 层不要开窗露铜。

电源建议采用星型走线方式，见图 4-2 高亮部分走线。特别注意 9 脚电源脚不要跟 10,11 脚直接接一起，各电源脚采用星型走线，除数字 IO 电源脚，其余每个电源脚单走一根电源线到主电源上，避免芯片内部各个供电互相串扰。所有芯片电源脚所接电容均应靠近芯片电源脚放置。

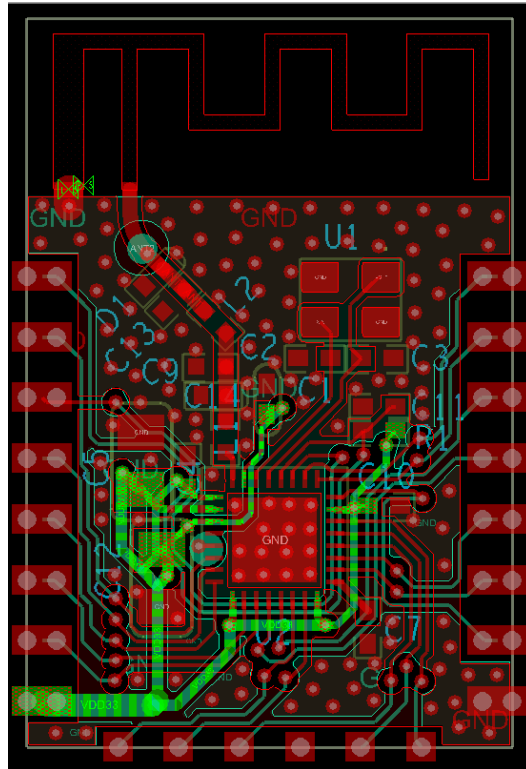


图 4-2 电源星型走线

5 天线设计

根据客户需要可使用外置天线，也可以使用 PCB 板载天线。不同天线对产品性能可能会有不同的影响，需要根据天线阻抗实际调整匹配元件。

5.1 外置天线

对连接外置天线的连接座尽可能远离底板电源等噪声源，防止干扰天线。

5.2 板载天线

当模块使用 PCB 板载天线设计时，需严格按照本指导书设计，防止天线性能下降，影响产品使用。

天线背面敷铜需全部挖空，天线参考地平面尽可能大，高亮绿色区域是天线部分，绿色区域所有层均不能敷铜，全部净空。并且绿色天线区域 PCB 需要盖油，禁止天线有铜皮裸露。黄色高亮区域是射频匹配器件及走线区域，需要做 50 欧姆阻抗控制。见图 5-1。

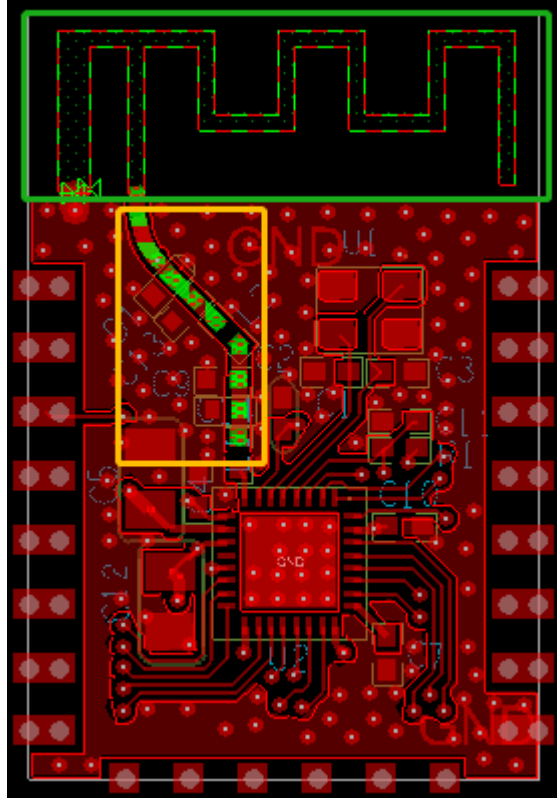


图 5-1 天线 layout 建议

图 5-2 常用且对天线性能影响较小的天线摆放方式，尽可能保证天线周围没有实体遮挡物体。

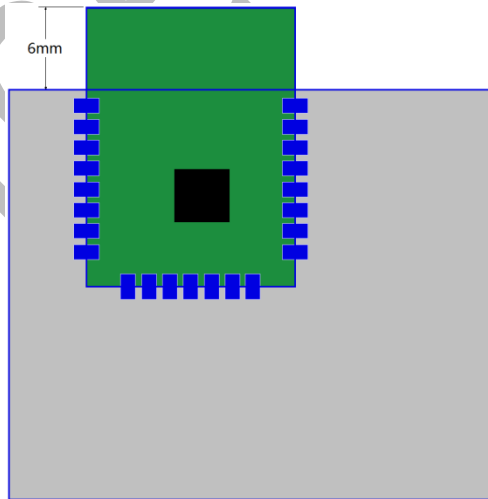


图 5-2